

### 請求の範囲

- [請求項1] 有機酸（A）および導電性フィラー（B）を含有する導電性接着剤組成物であって、
- 前記導電性接着剤組成物の全体量に対して前記有機酸（A）を0.01～0.2質量%、前記導電性フィラー（B）を85質量%以上含有し、
- 前記有機酸（A）は、酸解離定数 $pK_a$ が4.8以下である導電性接着剤組成物。
- [請求項2] 前記有機酸（A）は、分子量が170以上である請求項1に記載の導電性接着剤組成物。
- [請求項3] 前記有機酸（A）は、アビエチン酸、ピマール酸、イソピマール酸、パラストリン酸、デヒドロアビエチン酸、ネオアビエチン酸、セバシン酸、アスコルビン酸、スベリン酸からなる群より選ばれる少なくとも1の有機酸である請求項1または2に記載の導電性接着剤組成物。
- [請求項4] バインダ樹脂（C1）を含有し、さらに希釈剤（C2）、硬化剤（C3）、及び硬化促進剤（C4）からなる群より選ばれる少なくとも1つを含有してもよく、
- 前記導電性フィラー（B）の含有量を[B]質量%、前記バインダ樹脂（C1）、前記希釈剤（C2）、前記硬化剤（C3）、及び前記硬化促進剤（C4）の含有量の和を[C]質量%としたとき、 $[B]/[C]$ が95/5以上である請求項1～3のいずれか1項に記載の導電性接着剤組成物。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1項に記載の導電性接着剤組成物を硬化した、導電性接着剤硬化物。
- [請求項6] 請求項1～4のいずれか1項に記載の導電性接着剤組成物を部品の接着に使用した電子機器。